



Fubon Global Equity Division

2026 年 07 月 30 日

Teradyne, Inc (TER)

公司簡介

Teradyne (TER) 為全球領先的自動化測試設備供應商，專注於半導體、系統與電子產品的測試解決方案。公司產品廣泛應用於邏輯晶片、記憶體、類比與混合訊號、車用電子與工業應用，客戶涵蓋主要晶片設計與製造商。近年來，Teradyne 持續受惠於 AI、HPC 與先進製程推動的測試需求，同時透過工業自動化與協作型機器人布局，拓展長期成長動能並提升營運多元性。

TERADYNE

基本資訊

收盤價	\$319.41
產業別	半導體材料及設備
市值 (百萬)	\$50,001.13
流通在外股數 (百萬)	157
過去1年股價區間	\$89.18 - \$487.91

分析師預估

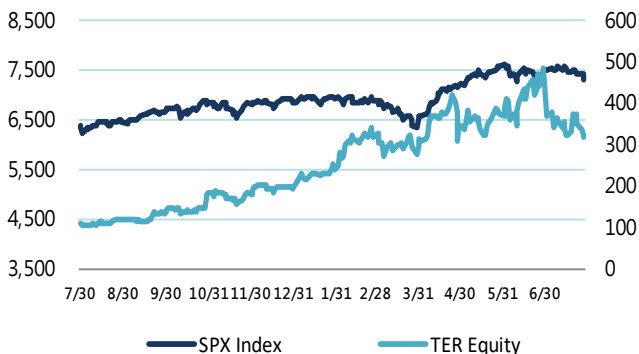
12個月目標價	\$434.73
評等	
買進	14
持有	4
賣出	1

股價表現

5日股價漲跌幅	-13.5
近1月股價漲跌幅	-31.0
近3月股價漲跌幅	4.3
近12月股價漲跌幅	252.7
YTD	65.0

季損益表	F2Q26A	F3Q26F	F4Q26F	F1Q27F
營收	1,329	1,115	1,006	1,317
YoY%	103.90	45.01	- 7.15	2.71
毛利率	59.80	58.62	58.32	59.56
EBIT	448	305	282	415
Net income	389	252	214	352
non-GAAP EPS	2.47	1.71	1.58	2.26

近期股價走勢



年損益表	FY25A	FY26F	FY27F	FY28F
營收	3,190	4,505	5,891	7,121
YoY%	13.13	41.23	30.76	20.88
毛利率	58.26	59.20	59.55	59.99
EBIT	710	1,489	1,971	2,617
Net income	632	1,261	1,669	2,119
non-GAAP EPS	3.96	7.32	10.59	14.17

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

座談重點摘要

1. AI 資料中心持續擴建帶動 WFE 投資、先進封裝及測試強度同步提升，ATE 市場已由過去落後半導體設備成長，轉為成長速度優於 WFE。公司預期測試設備占半導體資本支出比重可維持 7%至 9%，長期 ATE TAM 有機會突破 200 億美元。2027 年成長動能將來自 WFE 持續擴張、先進封裝普及及 AI 晶片測試需求增加，市場進入中長期結構性成長階段。
2. 公司表示第二家大型 AI Hyperscaler 已完成 Correlation 驗證，Merchant GPU 開始出貨，雙供應商策略將逐步推動 Compute 市占率於 2027 年開始提升。Memory 業務則受惠 HBM、DDR 需求優於預期，以及 NAND Final Test 復甦，客戶 Book-to-Bill 維持 2 倍以上，顯示記憶體廠已提前規劃 2027 年產能擴充，Memory 與 Compute 可望共同支撐未來兩年營運成長。
3. 公司持續推動「Wafer to AI Data Center」策略，除半導體測試外，亦積極布局高速光通訊、Board Test 及自動化設備市場。CPO 測試市場預估 2028 年可達 3 億至 7 億美元，公司透過 Quantifi Photonics、Photon 100 及 MultiLane Test Products 等布局完整光互連測試方案；Robotics 則受惠電子製造、ODM 及資料中心自動化需求快速成長，預期中期成長速度將與整體 AI 基礎建設投資同步提升。

公司近況更新

1. 2Q26 營收突破 13 億美元、季增 4%、年增逾 100%，非 GAAP EPS 達 2.47 美元、年增逾 300%。Semi Test 營收逾 11 億美元，其中 SOC 為 8.43 億美元、Memory 為 2.12 億美元；毛利率 59.8%，營業利益率 33.7%，自由現金流 3.78 億美元，AI 相關營收占比超過 60%。
2. 3Q26 營收指引為 12 億至 13 億美元，非 GAAP EPS 為 1.85 至 2.15 美元，毛利率預估 58%至 59%，營業費用率約 29%至 30%，營業利益率約 28%至 30%。營收較 2Q26 高峰略降，主要受 Compute 訂單時點與 Mobile 轉弱影響，但 Memory、Auto、Industrial、IST、Product Test 及 Robotics 需求仍維持成長。

3. 公司將上半年營收占全年比重調整為 50%至 52%，反映下半年需求較原先預期改善，且訂單能見度持續提升。Memory、IST、Auto、Industrial、Product Test 與 Robotics 預計下半年優於上半年，可部分抵銷 Compute 季節性回落。FY26 全年毛利率估約 59%，公司並預期 ATE 市場擴張與 AI 需求將延續至 2027 年。

Q&A

Q：WFE 與 ATE 市場規模的關聯性為何？測試設備占半導體資本支出的合理比例是多少？

A：公司表示，測試設備支出占整體半導體資本支出的比重近年明顯上升，2023 年約僅 4%，2025 年提高至約 7%，2026 年前五個月進一步升至約 8%，顯示 ATE 市場成長速度已開始超越晶圓製造設備市場。公司認為，先進封裝為測試支出比重上升的重要原因，隨著 AI 加速器、CPU、網通晶片與 HBM 採用更多 chiplet 及多晶粒封裝，單一晶粒的潛在缺陷可能造成整個高價值封裝失效，因此客戶必須提高晶圓測試、最終測試及系統層級測試的強度。公司目前判斷，測試設備占整體半導體資本支出的比例長期可能落在 7%至 9%區間，較合理的中樞可能為 7%至 8%，但部分年份亦可能接近 9%。公司並不預期測試占比會持續無限制上升，主要原因在於測試效率改善、測試時間縮短及產品良率提升，仍可能抵銷部分測試需求。不過，若全球 WFE 支出於十年末接近 2,500 億美元，按照 7%至 9%的測試設備占比估算，整體 ATE 市場規模具備達到或超過 200 億美元的潛力，明顯高於過去市場對 ATE 長期成長性的認知。

Q：新客戶認證何時開始轉化為市占率提升？長期市占率目標為何？

A：公司認為，2026 年整體 SOC 測試市占率可能大致持平或小幅提升，真正較明顯的市占率成長預計自 2027 年開始反映，但提升過程將是逐一產品、逐一 socket 推進，而非單一年度快速跳升。公司目前在多數測試市場均有市占率提升，但成長最快的 AI Compute 市場，恰好也是公司歷史市占率相對最低的市場，因此即使公司在其他領域持續擴大市占，整體 SOC 市占率仍可能

因市場組合快速轉向 AI 加速器而呈現平穩。公司認為，2026 年的重要進展並非整體市占率大幅增加，而是 Compute 市占率已停止下滑，並開始出現向上拐點。大型 AI 客戶導入第二供應商通常需要經過競標機會、開發可運作方案、Correlation 驗證及正式量產四個階段，從專案啟動到量產一般需要 9 至 12 個月；第一顆雙供應商產品量產後，後續產品會進入 fast follower 階段，公司可逐步將更多晶片平台轉換至公司測試平台，市占率可能由接近零逐步提升至約 30%。公司目前擁有一個已進入成熟雙供應商階段的 Compute 客戶、一個處於 fast follower 階段的客戶，以及一個仍在量產前認證階段的客戶。公司未提供 40%或 42%的明確長期市占率目標，但公司強調，2027 年起新認證、Merchant GPU 出貨及第二家大型雲端客戶的雙平台導入，將逐步轉化為實際營收與市占率提升。

Q：「Wafer to Data Center」策略是否代表公司將整合所有測試站點？

A：公司表示，「Wafer to Data Center」策略的核心並非全面垂直整合所有測試設備、搬運設備與自動化設備，而是在晶圓、封裝、系統、電路板、光學互連、資料中心機櫃及自動化組裝等不同環節提供測試與機器人解決方案。公司在各個測試階段通常仍是開放式生態系統的一部分，例如半導體測試機會與不同供應商的 Handler、Probe Card、Socket 及 Material Handling 設備整合，光通訊測試亦需要與光學元件、矽光子、封裝及連接器供應商合作。公司認為，客戶重視開放式供應鏈，因此公司不會試圖封閉整個生態系統。矽光子市場為最明顯的案例，現階段各家供應商多針對特定早期客戶進行一對一合作，但隨著市場成熟，預期最終仍會形成不同測試設備供應商與多家搬運、封裝及光學設備供應商互相相容的開放平台。公司同時認為，單一供應商可橫跨 Wafer Sort、Final Test、System-Level Test、Burn-in 及 Board Test，確實能為客戶提供資料、軟體、測試程式與故障分析的整合價值，但客戶仍會在每個測試環節選擇最佳方案，因此公司必須在每個站點個別競爭，不能僅依靠整體解決方案綁定客戶。

Q：供應鏈重組與雙供應商策略將如何影響公司？

A：公司表示，供應鏈韌性已成為 AI Compute 客戶最重要的考量之一。AI 加速器、CPU、網通晶片與 HBM 供應鏈涉及晶圓代工、先進封裝、基板、記憶體、測試與組裝等多個環節，整體供應能力取決於最薄弱的供應鏈節點，因此大型客戶不願在任何關鍵製程依賴單一供應商。測試設備亦屬於關鍵供應鏈環節，客戶不僅關心單一測試設備供應商可以提供多少產能，更希望透過兩家以上供應商確保所需產能能在指定時間到位。公司認為，雙供應商策略將成為未來數年推動公司 Compute 市占率提升的重要結構性因素。公司過去在部分 AI 加速器與大型雲端客戶的市占率較低，但當客戶主動要求第二供應來源時，公司將獲得進入原先單一供應商市場的機會。雙供應商導入初期通常只涵蓋單一產品或少量產能，後續隨著測試結果、穩定性與服務能力獲得驗證，客戶才會逐步將更多產品轉移至公司平台。因此，雙供應商策略的營收貢獻將呈現漸進式成長，但一旦公司進入成熟雙供應商階段，後續新產品可在開案初期直接於兩個測試平台同步開發，市占率提升速度將顯著加快。

Q：Robotics 業務的 AI 成長動能與中期展望為何？

A：公司預期 Robotics 業務中期成長速度將大致與公司整體成長速度一致，主要驅動力來自 Physical AI、電子製造、半導體與資料中心相關自動化需求。Robotics 目前成長最快的終端市場為電子製造與半導體，相關營收在 2Q26 較 1Q26 成長約 50%，並已成為 Robotics 最大的終端市場。AI 資料中心建置需要大量伺服器、機櫃、電路板、光模組、散熱與電源系統，Contract Manufacturer 與 ODM 必須擴充組裝、測試及物料搬運產能；同時，美國與其他地區推動供應鏈在地化，製造成本較高，進一步提高自動化設備與協作型機器人的採用意願。公司認為，資料中心設備的高複雜度、快速產品迭代與高品質要求，非常適合導入具備彈性的機器人輔助組裝及測試。公司美國 Robotics 營收已占 Robotics 總營收約 32%，美國製造中心亦預計於 2026 年稍晚啟用，有助於縮短交期、服務在地客戶並受惠於製造回流。公司未將 Robotics 視為獨立於 AI 之外的傳統工業自

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

動化業務，而是將 Robotics 納入「Wafer to Data Center」策略，預期 Robotics 將伴隨資料中心機櫃出貨、電子製造投資與 Physical AI 應用同步成長。

Q：Memory 業務下半年與 2027 年的主要成長動能為何？

A：公司表示，2026 年 Memory Test 市場規模可能較 2025 年成長超過 40%，且下半年市場規模將高於上半年，主要由 HBM、DDR 及 NAND 三項需求共同推動。年初公司原先預期 HBM 將是最主要的成長來源，原因在於 2024 年 HBM 測試設備投資大幅成長、2025 年進入部分消化期，而記憶體廠長期 HBM 擴產計畫已顯示 2026 年將重新進入強勁成長。實際營運表現中，DDR 需求強度高於公司年初預期，背後因素包括 Server CPU 需求回升、Agentic AI 推動 CPU 與記憶體配置增加，以及 SOCAMM 等新型記憶體模組採用 LPDDR，帶動 DDR 與 LPDDR 測試需求。NAND 方面，公司年初已判斷資料中心儲存需求與 NAND 產能規劃之間存在缺口，但當時記憶體客戶尚未正式增加設備訂單；目前公司已觀察到 NAND 需求轉折，客戶開始要求增加 NAND Final Test 產能，代表 NAND 復甦已由預期轉為實際訂單。公司 2Q26 Memory 營收達 2.12 億美元，連續第三季超過 2 億美元，Book-to-Bill 超過 2 倍，顯示客戶正在為更長期產能需求提前下單。展望 2027 年，公司不預期 Memory 業務出現明顯上半年集中或劇烈波動，因記憶體廠正在增加 WFE 投資、新廠逐步量產，並已開始規劃 2027 年的測試設備需求，HBM、DDR 與 NAND 均有望維持成長。

Q：3Q26 毛利率下降的原因為何？2027 年毛利率趨勢如何？

A：公司 3Q26 毛利率指引為 58%至 59%，低於 2Q26 的 59.8%，主要原因包括產品組合改變、第一季與第二季部分一次性有利因素不再重複、新產品導入成本，以及 Memory 產品占比提高所帶來的結構性壓力。公司指出，單季毛利率原本就具有較高波動性，過去五年單季之間的毛利率波動幅度可達約 400 個基點，但年度毛利率通常落在約 200 個基點的相對窄幅區間，因此不應僅依單季變化判斷長期獲利結構。上半年公司 Compute 與 Semi Test 營收占比較高，相關產品組

合較佳，加上部分非經常性、非營運因素提供毛利率挹注；下半年營收成長將更多來自 Auto、Industrial、IST、Product Test、Robotics 及 Memory，相關業務的平均毛利率組合低於上半年高比重的 Compute 業務。新產品上市初期亦可能因產量尚未達經濟規模、製造成本較高及供應鏈尚在優化，對毛利率造成短期壓力。公司預估 2026 年全年毛利率約 59%，略低於既有 Target Earnings Model。展望 2027 年，Memory 成長仍可能對公司整體毛利率形成壓力，但公司並未觀察到客戶組合、產品組合或定價出現重大結構性惡化，年度毛利率預計維持在歷史合理區間，不預期出現顯著年減。

Q：WFE 成長與 ATE 成長的關聯性為何？2027 年 ATE 是否會跟隨 WFE 成長 30%以上？

A：公司表示，WFE 與 ATE 之間具有明顯的中長期關聯，但相關性較適合觀察三至五年期間，不適合直接用單季或單一年度 WFE 成長率推估 ATE 成長率。WFE 支出增加代表晶圓廠將新增更多製程設備、產能與先進節點，但設備安裝、廠務驗證、試產與良率爬坡需要時間，因此 WFE 營收通常領先晶圓實際產出約一年。當晶圓開始量產後，客戶才會根據實際產能、產品組合、良率及測試時間採購 ATE，公司測試設備交期約 16 週，因此 WFE 支出與 ATE 營收之間可能存在約三個季度至一年的時間差。2026 年公司營收成長速度明顯快於 WFE，部分原因是前期 WFE 投資已開始轉化為晶圓與測試需求，加上 AI 高階晶片的測試強度、HBM 需求及公司市占率提升共同推動 ATE 成長。展望 2027 年，即使 WFE 成長超過 30%，ATE 不一定同步成長相同比例，原因在於 2026 年測試設備占半導體資本支出的比重已由 2025 年的 7%上升至約 8%，2027 年可能維持 8%，亦可能回落至 6%至 7%。公司仍預期 2027 年 ATE TAM 將成長，但實際增幅將取決於 WFE 投資轉化速度、晶圓產出、產品良率、測試時間、設備利用率與測試效率，無法僅以 WFE 年度成長率一對一推算。

Q：為何 2027 年測試設備占半導體資本支出的比例可能下降？

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

A：公司說明，測試設備占半導體資本支出的比例下降，並不代表 ATE 需求轉弱，而可能只是 WFE 與 ATE 營收認列時點不同所造成的年度波動。晶圓製造設備通常在晶圓廠開始大量生產前數季至一年交付及認列營收，因此當某年度 WFE 支出大幅成長時，相關晶圓產能可能尚未正式量產，ATE 採購則會在後續期間才逐步增加。2026 年 ATE 成長較快，可能反映前一階段 WFE 投資及 AI 測試需求集中釋放；2027 年若 WFE 支出再度大幅增加，WFE 分母快速擴張，但新產能尚未完全產生測試需求，測試設備占比便可能由 8% 暫時降至 6% 至 7%。此外，ATE 需求亦受到產品良率與測試效率影響。若新產品良率偏低、客戶要求更高品質標準或多晶粒封裝需要更多測試插入點，客戶可能超額採購測試設備；相反地，若良率改善、測試程式優化、平行測試數增加或單顆測試時間縮短，客戶可能用較少設備完成相同晶片產量。因此，WFE 與 ATE 之間存在因果關係，但年度比例不會固定，較適合用長期平均及晶圓產出趨勢判斷 ATE 市場方向。

Q：公司在 Server CPU 測試市場的競爭位置如何？ARM 架構市占率提升是否有利於公司？

A：公司表示，Server CPU 測試需求正在轉強，CPU 市場已成為 Compute 業務的重要成長來源。公司在 ARM CPU 生態系的歷史曝險與市占率高於 x86 生態系，因此若 Server CPU 市場持續由 x86 部分轉向 ARM，公司將獲得更大的市占率提升機會。大型雲端服務供應商正增加自研 ARM CPU 的部署，Agentic AI 亦需要更多通用運算資源處理資料整理、工作負載協調、推論前後處理與控制任務，帶動 CPU 顆數及測試需求成長。公司同時積極爭取 x86 CPU 測試市場，並未將成長策略侷限於 ARM，但 x86 市場既有測試供應商關係較成熟，公司取得新 socket 與新平台的速度可能較慢。若 ARM CPU 在 Server CPU 市場的比重提高，公司不僅可受惠於 CPU 市場總量成長，也可能透過較高的既有平台覆蓋率同步提升 Compute 測試市占率。公司因此認為，ARM 架構滲透率上升為公司 Compute 業務的正向因素，但最終營收仍取決於 CPU 出貨量、每顆 CPU 測試時間、先進製程複雜度及公司在各個新平台的認證進度。

Q：CPU 與 Merchant GPU 相比，哪一項測試市場機會較大？

A：公司表示，單顆 AI 加速器或 GPU 的測試強度明顯高於 CPU，市場提出 CPU 測試強度約為 GPU 四分之一的估計大致合理，因此在相同晶片顆數下，Merchant GPU 或 AI 加速器帶來的 ATE 需求通常高於 CPU。不過，CPU 與 GPU 的市場價值不能只比較單顆測試強度，仍需考量 CPU 與加速器的實際出貨比例。若 Agentic AI、雲端運算與資料中心架構推動 CPU 顆數快速增加，CPU 測試市場仍可能成為重要成長來源。公司同時指出，AI 供應鏈存在多項瓶頸，包括先進製程晶圓產能、CoWoS 基板與封裝產能、HBM 供應及其他關鍵材料。客戶將根據可取得的資源，在自研加速器、Merchant GPU 與 CPU 之間調整產品組合，但無論最終產品組合如何，已投產的先進製程晶圓都必須接受測試。公司在自研加速器、Merchant GPU 與 CPU 三個領域均具備市占率提升機會，因此公司並不過度聚焦 CPU 與 GPU 何者成長較快，而是關注整體先進製程晶圓數量、晶片複雜度及各類 Compute 產品的測試秒數。Merchant GPU 單一大型客戶仍可能帶來顯著營收機會，但 CPU 市場若出貨量快速成長，同樣可形成可觀的測試設備需求。

Q：Silicon Photonics 與 CPO 的 Insertion 1 及 Insertion 2 是否可能合併或省略？

A：公司表示，Silicon Photonics 與 CPO 仍處於生產流程早期發展階段，不同客戶對 Insertion 1 與 Insertion 2 的定義甚至可能不同，因此現階段不宜將單一客戶的測試流程直接推廣至整個產業。一般而言，Insertion 1 可能在較早期的矽光子晶圓或電子 IC 階段進行測試，但 Insertion 1 完成 Known Good Die，並不代表後續光學引擎組裝完成後不需要再次測試。Insertion 1 至 Insertion 2 之間通常包括電子 IC 與 Photonics IC Wafer 的 Bonding，以及在矽光子元件上形成 Polymer Lens，該 Lens 為光學路徑的重要組成部分，並負責與 FAU 連接。由於 Insertion 1 階段尚未完成 Lens 與完整光學路徑，部分光損耗、偏振與連接品質測試無法在 Insertion 1 完成。因此，即使 Insertion 1 已確認晶粒功能正常，Bonding、Lens 形成與後續組裝仍可能引入新的缺陷。公司認為，真正需要討論的問題並非 Insertion 2 能否完全省略，而是完成 Bonding 後的測試應有多少在 Wafer

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

Level 執行，以及多少可延後至 Optical Engine Singulation 或更後段階段。公司判斷，部分 Insertion 2 測試功能仍屬必要，但最終測試站點、測試內容與設備價值量仍會隨量產流程成熟而調整。

Q：CPO 市場規模與 Networking 業務未來三年展望為何？

A：公司預估 2028 年 CPO 測試市場規模約為 3 億至 7 億美元，區間較寬主要反映 CPO 導入速度、Port 出貨量與量產良率仍存在高度不確定性。2027 年 Scale-out CPO 的早期大量量產是否順利，將決定 2028 年市場規模靠近 3 億美元或 7 億美元；若 2027 年主要客戶量產成功、良率穩定且 CPO 快速擴展至更多平台，2028 年市場規模可能接近區間上緣，若量產進度延後或技術仍需調整，市場規模可能接近區間下緣。公司推估 2027 年 CPO 市場規模可能約 2 億美元，較接近由 1 億美元向 3 億美元成長的低端路徑，2027 年的上行空間可能低於 2028 年。Networking 整體市場的成長機會則不僅限於 CPO。AI Frontier Model 需要更大規模的加速器叢集，帶動 Scale-out、Scale-across 及 Scale-up 連接數量快速增加；銅纜將逐步轉向 Backplane，高速 Pluggable 仍會持續成長，光互連亦可能依序經歷 NPO、XPO 及 CPO 等不同架構。公司透過 Quantifi Photonics、Photon 100 產品及 MultiLane Test Products 合資公司，同時布局矽光子、光學連接與高速銅連接測試。公司預期 Networking TAM 中期成長率可大致跟隨整體電晶體數量 15%至 20%的成長，公司在 Switch Silicon 測試亦具備穩固市場位置，因此即使 CPO 導入時程存在變數，整體 Networking 業務仍具備穩健的雙位數成長基礎。

Q：Memory Test 成長與 Bit Growth 的關聯為何？Auto 與 Industrial 何時回到前高？

A：公司表示，Memory ATE 與 Memory Bit Growth 具有正向關聯，但並非固定比例。Memory 測試市場包含兩項主要成長飛輪，第一項為 Bit Growth，記憶體位元產量增加將提高測試需求；第二項為 Technology Transition，例如 HBM3 升級至 HBM4、DDR5 升級至 DDR6，以及 NAND 層數與架構升級，都可能增加新測試平台、測試插入點與設備需求。部分記憶體測試需要測試每一個

bit，但相關市場主要由價格較低、差異化程度較小的設備服務；Final Test 與高階 HBM 測試則具有較高設備價值與技術門檻，因此 Memory TAM 不會單純按照 Bit Growth 同比例變動。2026 年公司 Memory 營收成長可能明顯高於 Bit Growth，原因包括前幾年 NAND 投資基期偏低、HBM 設備需求加速、DDR 需求優於預期，以及客戶集中補充測試產能。公司預期中期 Memory TAM 成長率可與 SOC TAM 接近，但 Memory TAM 絕對規模目前仍遠低於 SOC TAM。Auto 與 Industrial 方面，公司預期下半年營收優於上半年，2027 年可能恢復至或超越歷史高峰，但管理層表示相關判斷仍屬初步估計。中國市場存在本土化競爭，但公司目前中國 Power 產品組合占比較歷史高峰並未出現重大變化，公司仍與部分中國客戶維持良好合作。公司與 Infineon 相關合作最直接受惠領域為 Wide-Bandgap Discrete Test，雖然該市場目前占 Power 測試市場比重較小，但 SiC、GaN 等寬能隙元件預期維持快速成長，公司取得的技術與團隊有助於建立寬能隙分立元件測試的領導地位，並為 Auto、Industrial 及 AI 資料中心電源管理測試提供中長期成長動能。

公司近期新聞

1. [Vention and Teradyne Robotics Collaborate on Digital Twin Creation Platform Optimized for UR Robotic Cells](#)
2. [Teradyne Robotics Unveils Wide Range of Production-Ready Physical AI Applications at Automate 2026](#)
3. [Teradyne Introduces Integrated Test Solution for AI and Data Center Devices in Collaboration with Tokyo Electron](#)

近期投行報告觀點

公司核心業務受惠於網通、記憶體及先進運算測試需求成長，近期台灣進口資料亦顯示網通相關需求維持強勁。此外，市場關注的 TPU 測試資格認證及 AI 加速器測試需求，仍有機會成為後續成長催化劑，擴大公司在高階運算測試市場的布局。整體而言，公司核心業務維持健康成長，在 AI 基礎設施投資擴張趨勢下，未來獲利仍具上修空間。

所持看好理由：

- 網通測試需求維持強勁成長，帶動營收與獲利優於市場原先預期。
- TPU 測試資格認證進展受市場關注，有望開啟新的 AI 晶片測試商機。
- 記憶體市場復甦與 AI 運算需求擴張，持續支撐測試設備需求成長。

提醒留意風險：

- TPU 或 AI 晶片測試資格認證進度不如預期，恐影響新業務貢獻。
- 網通客戶拉貨動能放緩，可能影響後續營收成長表現。
- AI 晶片測試相關訂單拓展若不如預期，將影響市場對公司成長性的期待。



主要研究機構分析師評等

券商名稱	分析師	評等	目標價	日期
Morgan Stanley	Shane Brett	Equalwt/In-Line	397	2026/7/29
Stifel	Brian Chin	buy	390	2026/7/29
TD Cowen	Krish Sankar	buy	450	2026/7/29
Susquehanna	Mehdi Hosseini	Positive	550	2026/7/29
Aletheia Capital Limited	Steven Liu	buy	470	2026/7/29
Baird	Quinn Fredrickson	outperform	446	2026/7/28
Evercore ISI	Vedvati Shrotre	outperform	370	2026/7/28
JP Morgan	Joseph Cardoso	overweight	450	2026/7/16
Goldman Sachs	James Schneider	buy	465	2026/7/5
Citi	Atif Malik	buy	400	2026/5/21

◆ 內法業務二科 (海外股) 02-27725938 | Head of Sales— 楊佩瑾 Peichin ext. 61808 peichin.yang@fubon.com

郭家華 Queenie ext. 61838 queenie.ch.kuo@fubon.com	邱宗煜 Alvin ext. 61651 alvin.chiu@fubon.com	王能偉 Shawn ext. 61637 shawn.nw.wang@fubon.com	林子芸 Hannah ext. 61697 hannah.z.lin@fubon.com
石容榕 Doris ext. 61807 doris.jj.shih@fubon.com	賴柔璇 Angie ext. 61833 angie.lai@fubon.com		

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。